

課題番号 : F-19-TU-0102  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : 光半導体用パッケージの開発  
Program Title (English) : Development for optical semiconductor package  
利用者名(日本語) : 紺谷 亘、高木 亮平  
Username (English) : T. Kontani, R. Takaki  
所属名(日本語) : ウシオ電機株式会社  
Affiliation (English) : USHIO Inc.  
キーワード/Keyword : 研磨、接合、膜加工・エッチング

## 1. 概要(Summary)

光半導体用パッケージの開発における、シリコンミラー形成方法や、低熱抵抗化が可能なシリコン基板の形状について、東北大学ナノテク融合技術支援センターへ技術相談を行った。

その結果、シリコン基板の形状について、凹凸形状を有するシリコン薄化ウェハでは、プロセス中のウェハ割れリスクが高いため、フラットなウェハを使用するほうがよいとのアドバイスを受け、これに基づく形で、基本設計見直しを行うことにした。

## 2. 実験(Experimental)

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。